(9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭57-82236

Int. Cl.³
 G 11 B 7/24
 B 29 D 17/00

G 11 B

識別記号

庁内整理番号 7247—5D 7215—4F 7247—5D 7426—5D ❸公開 昭和57年(1982)5月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全3頁)

砂情報記録担体の複製金型の母型

3/70

11/00

20特

願 昭55-122624

@出

願 昭55(1980)9月3日

@発 明 者 沖野芳弘

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑩出 願 人 松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006番地

⑩代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 細 4

1、発明の名称

情報記録担体の複製金型の母型

2、特許請求の範囲

少なくとも表面層が調またはその合金からなる リレーフ状に情報が担持されていることを特徴と する情報記録担体の複製金型の母型。

3、発明の詳細な説明

本発明は情報記録担体の複製母型と関するものであり、一枚の記録原盤より多くの金型(スタンパ)を作り出す手段を提供することを目的とする。この発明が適用される情報記録報は例えば音声に 一 の発明が適まれた円燥、即ち通常 "レコード"と呼ばれる情報担体に対して適用される。本発明の有効性がより効果的に発揮されるのは特に情報密度がオーディオ・レコードに比べて数百倍以上 高いと言われるビデオ・ディスクに対してである。その他この種でリーン状情報を担持する高密配録報担体の複製金型を製造する手段として効果的に適用される。

現在最もこの種形式の複製が工業的に行なわれているのはオーディオ・レコードの複製においてであるが、ことでは最近実用化が始まった光学方式ビデオ・ディスクの場合を例にとってその工程を設明する。オーディオ・レコードの場合もその記録原義が異なるだけで基本的には全く同じ工程である。

 即ち通常マスタと呼ばれるものが完成する。これは引き続き重クロム酸カリ溶液中に浸漬する等により剥離処理 (パッシペーション) がほどこされその表面側にニッケル電鍋 6 が行われる。(第3四 ないとなったが、3 四 常マザと呼ばれる。 このときマスタ表面は銀であり、マザ表面はニッケルである。 次いで、前記同様マザに剥離処理をほどこしてその表明にニッケルアを電着させてマザより剥離することによって 齢級の複製金型 (スタンバ) (第4 図を得る。

との工程で配録原線よりマスタの作成は殆んどたった一枚を作るのが従来限度である。一方、マスタからマザ、マザからスタンハは原理的には無 膜枚数の作成が可能な様に思われる。しかし実際には、その間に母型の劣化が起り担持する信号情報ピット(レリーフ)が損傷するのでそこから再生される信号の信号対権音比の低下がおとり、その実用上の限度に応じた枚数のみしか作製するととができない。発明者の研究によれば光学方式とディズタにおいて信号対権音比の劣化の許容

6

以上望むべくは2ミクロン以上の厚さとなるまで 電着させ、その上にニッケル1〇を通常の手法に より数百ミクロンの厚みで形成させる。とのとき 鋼の電鍋は通常の硫酸鋼密に光沢添加剤を加えて 1~3 A/4m2の電流密度で行うと網結晶が微細 化し、また内部応力を極小化させて好ましい結果 を得ることができる。また最初の蒸着もしくはス パッタリングによって銅又はその合金を付着させ る工程は、銅の無電解メッキ法により行うことが できるが結晶が粗大化したり大きな内部応力を発 生することが多いので模力厚みをうすくすること が必要で500ォングストローム以下であること が好ましい。更に上記ではバッキングとしてニッ ケルを用いたが銅の電鱗をそのまま引き続き電流 密度を上げて行うこともできる。そのとき内部応 力をおさえるための工程管理に特に注意を払うべ もである。

この様にして作成された鋼表面層 9 を持つマス タは重クロム版カリ溶液への浸漬等により剥雑処 現を行った後、第 6 図に示すようにその表面層に 限度を-20IB以内とすればおよそち~10枚が限度である。仮に10枚としても1枚の記録原 解から作成可能なスタンパ数は歩智まり100%と仮定して10×10=100(枚)にしかすぎない。実際には金型複製における母型劣化は特にマスタの銀面で起り易く、いわゆる銀のハガレやサビの発生によって得ることができるスタンパの数は上記の%~¼にしかすぎず、現行のプレス方式でディスタを生産する場合、一原能よりの複製可能枚数は良く管理された工程においても数万枚以下である。

本発明は上記の問題を克服して一記録原維より、 より多くの良質な複製金型を作る手段を提供する。 ものである。

本発明の一実施例を以下に述べる。まづ、第1 図じ構成よりなる記録原総の表面上に第5図に示すように蒸着もしくはスパッタリングによって 200~5000オングストロームの厚さで網あるいは銅の合金を付着させる。次いで、電鶴法により銀の隔9の厚みが5000オングストローム

6 ._

再び倒あるいは網合金11の電光を行う。そのと を特に倒あるいは網合金11の表面層の厚みが数 ギオングストローム位まで形成されるまで結晶の 微細化及び内部応力の極小化に留意を払うべきで ある。その後は前配の従来の工程と同じでニッケ ル電調によりバッキング12をほどとして判離す ることにより第二の母型、即ちゃずを作成すること とができる。なお、表面層11の電離は第一の母 型作成と同様、蒸着やスパッタリングによって可 能である。

かくして得られた表面に網あるいは網合金層 1 1 を持つマザは前記同様剥離処理を煙どとし、 第 7 回に示すようにその表面層にニッケル電着を 行い所定の厚さまでニッケル層 1 3 を形成してディスク複製金型であるスタンパを作成することが できる。

発明者の注意楽い研究によれば、とのようにして出来たマスタ及びマザからは再生信号劣化の許容限度を信号対雑音比で-20IBとすると、約百枚の転写複製が可能であるとの結論が得られた。

特開昭57-82236(3)

この興由化ついては現在さらに研究中であるが、 一つの推測として銅そのものが元来化学的に活生 な金額であるため、刺産処理が振めて均一に効果 的に行われることと、ニッケルに比較してやわら かく、ねばりという鯛の物理的性質に起因してい ると思われる。

かくして本発明によれば、一記録原程より 1 〇〇×1 〇〇=1 万 (枚)の複製金型の作成が 容易に可能となるので、従来の1 〇〇~4 〇〇倍 程度のスタンバが安定に作成でき、工業的に言っ て一プログラムに一枚の原盤を作成すればよいと とになる。

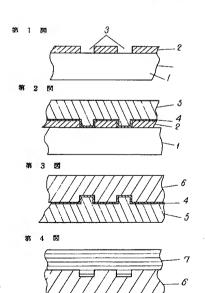
4、図面の詳細な説明

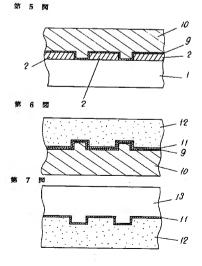
第1図は記録原髪の一部を示す断面図、第2図は従来の原盤からマスタの作成工程を説明するための断面図、第3図は従来のマスタからマザの作成工程を説明するための断面図、第4図は従来のマザからスタンパの作成工程を説明するための断面図、第5図は記録原盤から本発明の複製金型の母型(マスタ)を作成する工程を示す断面図、第

6 図は本発明による母型 (マスタ) より更に母型 (マザ) を得る工程を示す断面図、第7 図は本発明による母型 (マザ) よりスタンパを得る工程を示す断面図である。

1 ……ガラス板、2 ……レジスト膜、3 ……ピット、9, 11 ……鍋,銅合金層、10, 13 …
…ニッケル層。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名





PAT-NO: JP357082236A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57082236 A

TITLE: MOTHER MOLD OF DUPLICATED

METALLIC MOLD FOR INFORMATION RECORDING

CARRIER

PUBN-DATE: May 22, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

OKINO, YOSHIHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP55122624

APPL-DATE: September 3, 1980

INT-CL (IPC): G11B007/24 , B29D017/00 ,

G11B003/70 , G11B011/00

US-CL-CURRENT: 205/68

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce the deterioration of the surface at transfer and reproduction, by providing a copper or copper alloy on the surface, in a master and a mother such as video disc.

CONSTITUTION: On the surface of a recording mother disc consisting of a glass plate 1 and a residual resist film 2, copper or copper alloy having 200~5,000Å thickness is stuck by vapor deposition or sputtering. Next, a copper layer 9 is electrically deposited as far as $\geq 2\,\mu$ by the electrotyping method and nickel 10 is formed thereon in several hundreds μ thickness. After the master 10 having the copper surface layer 9 is peeled off with immersion to potassium dichromate solution, a copper 11 is electrodeposited further on the surface layer 9. The backing 12 is made with nickel electrotyping for peeling, allowing to form a mother 12 with a copper surface layer 11.

COPYRIGHT: (C) 1982, JPO&Japio